

1-829265-6 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU HV-100/HV-190

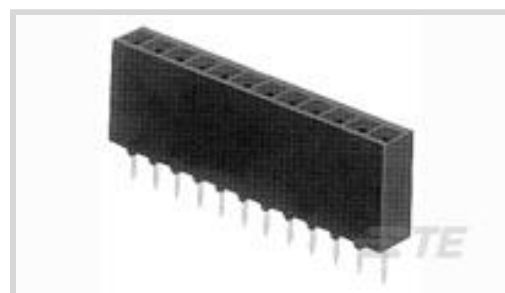
TE 内部编号 1-829265-6

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 16 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU HV-100/HV-190

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 16

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	否
位数	16
行数	1
PCB 安装方向	垂直

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	绿色

接触件特性

端子保护类型	闭合入口壳体
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 μ m
接合插针直径	.64 mm[.025 in]

端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.7 mm[.027 in]
端接柱体和尾部长度的	3.05 mm[.12 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	底部和顶部
外壳材料	聚酯 - GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

堆叠高度	2.29 mm[.09 in]
连接器高度	6.2 mm[.244 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

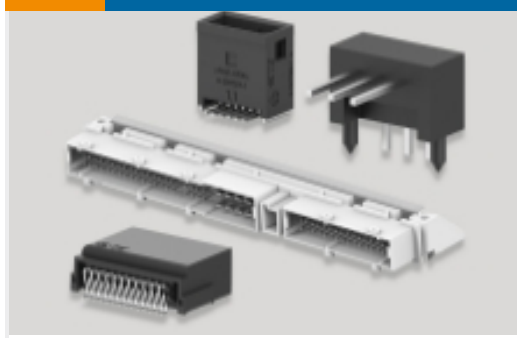
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

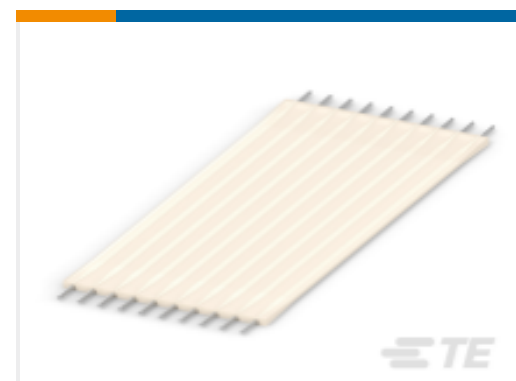
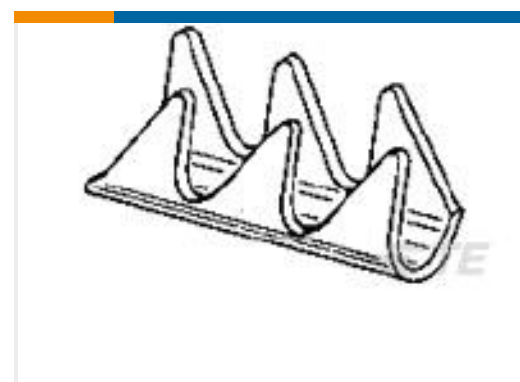
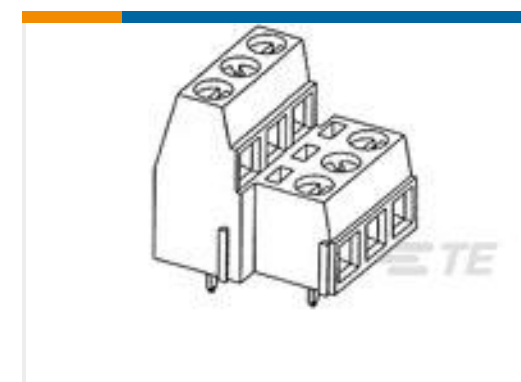
<p>TE 产品编号 1-826629-6 16X1 AMPMODU II HDR ST</p>	<p>TE 产品编号 1-826631-6 AMPMODU II HEADER</p>	<p>TE 产品编号 1-826646-6 16P AMPMODU II STIFT LEI</p>	<p>TE 产品编号 1-826647-6 16P AMPMODU II STIFT LEI</p>
<p>TE 产品编号 1-826648-6 16P AMPMODU II STIFT LEI</p>	<p>TE 产品编号 1-966710-6 MODU II PIN HEADER, SGL ROW, SMD- 16 POS</p>		

该系列中的其他产品 | AMPMODU HV-100/HV-190



PCB 板端连接器及母端(333)

客户还购买了

TE 产品编号DT15-12PA-G003
DEUTSCH DT HeadersTE 产品编号3-2176055-9
RLP73K 2B R39 1% 1K RLTE 产品编号2205341-1
FSN-11.4A-5TE 产品编号826467-7
7P MOD II SHROUDED HEADER, STTE 产品编号1-1825190-0
DIP Shunt, 12 posTE 产品编号926933-3
WIRE PIN 18-17 AWG .01 PTPBTE 产品编号2-1761609-6
IDC LOW PRO HDR 16P RA SHT LATTE 产品编号282869-3
TERMI-BLOK PCB MOUNT 1&2 3P.5,

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-829265-6_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-829265-6_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-829265-6_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

1-829265-6

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 16 Position, 2.54 mm [.1 in]
Centerline, Gold, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU HV-100/HV-190



[1773393_AMPMODU_EUROPEAN_STANDARD_PRODUCTS](#)

英文版本